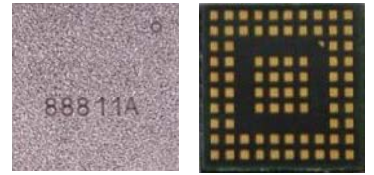


支持IEEE 802.11ac & Bluetooth SDIO型 System-in-Package(SiP) 模块

支持Wi-Fi和Bluetooth的组合模块



SX-SDPAC

除IEEE 802.11a/b/g/n/ac 之外，还支持Bluetooth 4.1
支持Wi-Fi和Bluetooth的组合模块

概要

SX-SDPAC是一款搭载了高通创锐讯公司QCA9377片上系统（SoC）的，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac和Bluetooth 4.1 BR/EDR/HS/LE的SDIO SiP（System-in-Package）模块。

在主机接口方面，为无线局域网搭载了SDIO3.0接口，为蓝牙搭载了高速UART接口。

本产品内置了RF前端，可以在减轻RF周边电路开发负担的同时，还能通过一根外部天线实现对5GHz和2.4GHz的两个频带的控制。此外，本款产品为6.9mm x 6.9mm的紧凑尺寸，可帮助客户实现基板的小型化。

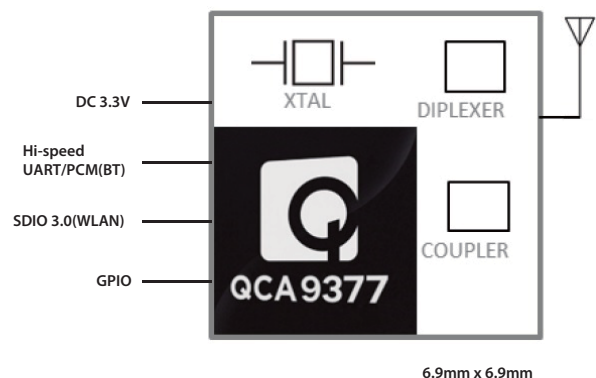
特点

- 支持双频 Wi-Fi & Bluetooth4.1
- 低功耗 1x1 SiP 模块
- 采用Qualcomm Atheros公司的QCA9377-3 SoC
- PHY数据速率最大 433Mbps (11ac VHT80时)
- 搭载了支持SDIO3.0的无线LAN主机接口
- 支持Bluetooth UART主机接口
- 主电源：3.3V、IO电源：1.8V或3.3V
- 符合RoHS指令（2011/65/EC）
- 小型尺寸 6.9 x 6.9 x 1.1 mm
- 80针 LGA封装

产品规格

型号	SX-SDPAC
芯片组	Qualcomm Atheros公司生产的 QCA9377
主机接口	无线LAN : SDIO Bluetooth : Hi-speed UART
无线LAN规格	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth规格	Bluetooth 4.1 BR/EDR/HS/LE
工作电压	主电源 : 3.3V ±5% IO电源 : SDIO2.0工作时 3.3V ±5% SDIO3.0工作时 1.8V ±5%
功耗 (无线LAN)	【2.4GHz】 发送 - Typ. 305mA ~ 340mA 接收 - Typ. 85mA 【5GHz】 发送 - Typ. 410mA ~ 490mA 接收 - Typ. 115mA
功耗 (Bluetooth)	发送 - Typ. 90mA 接收 - Typ. 45mA
外形尺寸	6.9mm x 6.9mm x 1.08 mm
保存环境条件	保存温度 : -40 ~ +85°C 保存湿度 : 10 ~ 85%RH

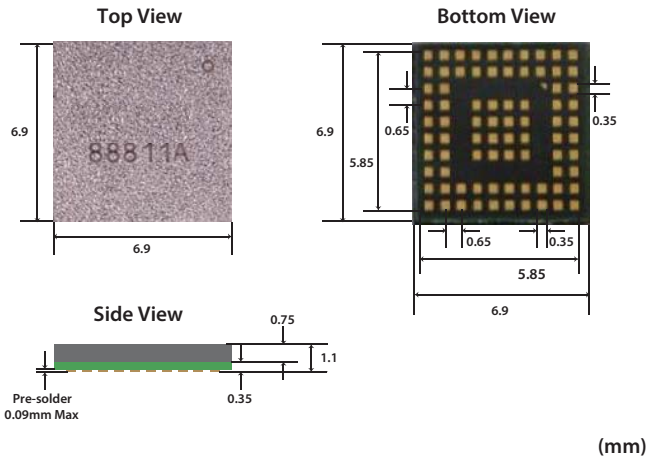
配置图



6.9mm x 6.9mm

尺寸图

本体



EVK



评价套件

为了便于对SX-SDPAC的无线功能进行评价，我们备有评价用套件（SX-SDPAC-EVK）及评价环境构建指南。注意，本评价套件将在SDIO2.0规格下工作。

- SX-SDPAC-EVK附件
 - 评价板（SX-SDPAC-EVK）
 - 天线
 - 评价环境构建指南
- 建议评价环境
 - 评价板：NXP生产的i.MX6 SoloX
 - 操作系统：Linux
 - 驱动程序：
- 可实施的测试
 - 无线局域网通信速度、距离
 - 无线局域网参数调整
 - 信道设定
 - AP/STA模式切换
 - 各种认证・加密方式的确认



SX-SDPAC-EVK



NXP公司生产的i.MX6 SoloX【另售】

● 连接示意图

无线驱动程序

- 参考平台：NXP公司的i.MX6 SoloX
- 支持的OS：Linux
- 支持的功能
 - 工作模式：AP（可连接台数：8台）
 - 认证方式：Open System、WPA2-PSK
 - 加密方式：无、AES
 - WPS v2.0（支持PBC、PIN码、外部Registrar）
 - WDS

产品阵容

型号	类型	捆包单位	捆包
SX-SDPAC-2830	量产SKU	3,000套	卷装
SX-SDPAC-2830-SP	样本装	10式	卷装
SX-SDPAC-EVK	评价套件	1套	单装箱

评估步骤

可按以下步骤，对本产品进行评估。

- ① 购买「SX-SDPAC-EVK」
- ② 由用户准备评估所需器材
- ③ 由用户准备Linux操作系统、开源驱动程序
- ④ 构建评估环境
- ⑤ 开始评估

● 资料中记载的公司名称及产品名称为各公司的注册商标或商标。
● 因改良需要，可能会在未经事先通知的情况下进行变更。资料中记载的规格为截止至2018年5月的内容。